

1-5-3-7 スルーホ - ル穴バリ突起／通孔披鋒的凸出 / Projected conductor by through-hole burr

【特徴】スルーホールの入入口部に出来ている突起状銅めっき欠陥

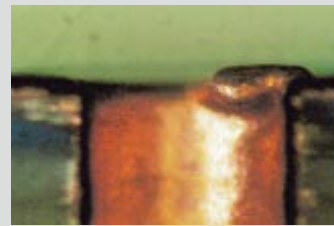
【特征】在通孔的入口有突起状的镀铜缺陷

【Characteristics】Through-hole plating defect that is projected at a hole entrance

【原因・判断ポイント・発生工程】スルーホール用穴あけ時に出来たバリがデバリングできずに残り、そのバリを核にして銅めっきが析出して出来たもの（穴明け工程、銅めっき肯定）

【原因、判断要点、发生工序】钻孔时发生的披鋒没有消除，以披鋒为晶核沉积镀铜层而引起的（钻孔工序、镀铜工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】The burr occurred at drilling is incompletely removed. Copper is deposited on the remained burr as a nucleus. (Drilling and copper plating process)



【コメント】顕微鏡倍率×

【注釋】显微镜倍率 ×

【Comments】Magnification: ×



【コメント】顕微鏡倍率×

【注釋】显微镜倍率 ×

【Comments】Magnification: ×

1-5-3-8 金めっき表面粒状突起／镀金表面的粒子凸出 / Granular nodule on gold plated surface

【特徴】金めっき表面に粒状の突起がある状態の欠陥

【特征】在镀金层表面有粒子状凸出的缺陷。

【Characteristics】Granular nodule on gold plated surface.

【原因・判断ポイント・発生工程】導体表面にできた何らかの微細銅核に金めっきされたり、金めっき条件の不適などにより出来たもの（銅めっき工程、金めっき工程）

【原因、判断要点、发生工序】在导线表面的某种细微铜核上沉积金层，或者镀金条件不合适等所引起的（镀铜工序，镀金工序）

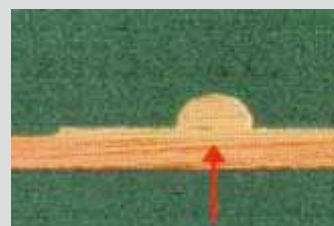
【Causes/processes involved/keys to judgment】The defect is caused by gold plating on a base conductor surface with fine granular copper or an improper gold plating condition (Copper plating and gold plating process)



【コメント】顕微鏡倍率×

【注釋】显微镜倍率 ×

【Comments】Magnification: ×



【コメント】顕微鏡倍率×

【注釋】显微镜倍率 ×

【Comments】Magnification: ×